

スーパーソルダー (SS) パッケージ用鉛フリーソルダペースト

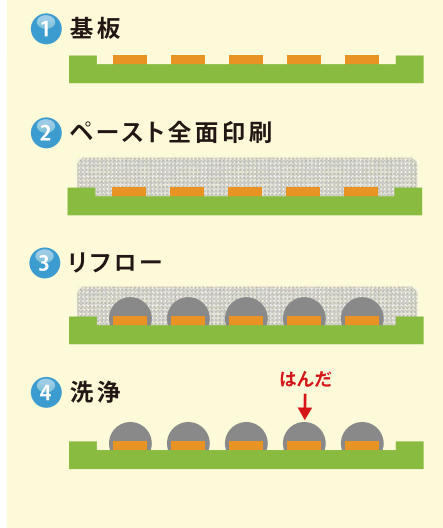
パッケージ内部の bumps 形成材料

スーパーソルダー (SS)、SAC-Nシリーズ、SAC-Uシリーズ

スーパーソルダー (SS) はペリフェラル電極基板のはんだプリコートに用いるペースト材料です。

ペリフェラル：全面印刷プリコート法

プリコートプロセス

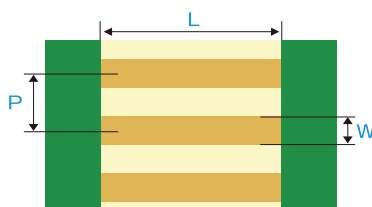


プリコート事例

基板条件	1	2	3	4
パッド形状	ストレート			
パッド配置	インライン		スタガード	
ピッチ、P	60	50	35	30
パッド長、L	120	80	140	120
パッド幅、W	30	20	35	30
平均はんだ高さ	14	12	14	13
標準偏差	1.4	1.3	1.4	1.3

(単位:μm)

※) プリコートスペックは保証値ではなく代表値です。



P: ピッチ L: SR開口長 W: パッド幅

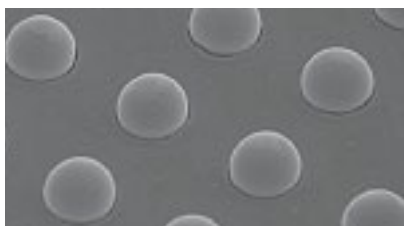


▲ 50 μmピッチ基板へのはんだプリコート

SAC-Nシリーズ、SAC-Uシリーズはエリアアレイ電極へのはんだ bumps 形成材料です。

エリアアレイ：低 α bumps 形成対応

bumps 形成例 (150 μmピッチ基板 / SAC-U-330使用の場合)



- 平均はんだ高さ: 35μm*
 - 標準偏差: 2
- *基板条件などにより異なります。

用途	ファインピッチエリア bumps 形成		超ファインピッチエリア bumps 形成	
	SAC-N-400	SAC-U-600	SAC-N-110	SAC-U-330
低 α 線	非対応	対応	非対応	対応
α 線カウント	high α	< 0.002 cph/cm ²	high α	< 0.002 cph/cm ²
はんだ組成	Sn-3.0Ag-0.5Cu		Sn-3.0Ag-0.5Cu	
融点	220 °C		220 °C	
金属粒径	5-15 μm		1-10 μm	
粘度	280 Pa·s		300 Pa·s	